



ייצור ב-TSMC. תמונת יח"צ

פעולה לשתף בכוונתן כי הודיעו TSMC-i, (FPGA) המתכנתים הרכיבים ספקית, (זיילינקס) Xilinx ביצירת ה-FPGAs בעלי רמת הביצועים הגבוהה ביותר וזמן היציאה לשוק המהיר ביותר שייבנו על תהליך מספקות החברות שתי FinFast. השם את לתוכנית העניקה זיילינקס TSMC. מבית ננומטר 16-ב FinFET משאבים ייעודיים כ"צוות אחד" והן תעבודנה יחדיו במטרה למטב את תהליך ה-FinFET עם ארכיטקטורת ה-UltraScale של זיילינקס. התוכנית תספק שבבי בדיקה ל-FinFET ב-16 ננומטר במהלך שנת 2013 ומוצר ראשון ב-2014.

בנוסף, עוסקות החברות במינוף זרימת הייצור IC 3D CoWoS של TSMC עבור הרמות הגבוהות ביותר של אינטגרציית מערכות IC-3D וביצועים ברמת המערכת. מוצרים שייצרו כתוצאה משיתוף פעולה זה יוכרו בהמשך.

"אני סמוך ובטוח ששיתוף הפעולה שלנו עם TSMC בתוכנית FinFast המתמקדת בצומת של 16 ננומטר, יוליד תוצאות מובילות בשוק בדומה לאלה שממן נהגנו בטכנולוגיות מתקדמות מהדור הקודם" אומר משה גבריאילוב, נשיא ומנכ"ל זיילינקס. "אנחנו מחויבים ל-TSMC כמפעל המוביל ללא עוררין בכל מימד, מטכנולוגיית התהליך ועד לאפשר תכנון, שירות, תמיכה, איכות ואספקה".

לאחרונה הודיעה TSMC כי היא מתכננת להאיץ את לוח זמני הייצור של תהליך ה-FinFET 16nm שלה לשנת 2013. שיתוף הפעולה של TSMC וזיילינקס ינצל במלואו את לוח הזמנים המואץ הזה, כמו גם את הביצועים התחרותיים והחיסכון בהספק שמציעה טכנולוגיית ה-FinFET ב-16 ננומטר של TSMC.

זיילינקס עבדה עם TSMC כדי להחדיר את הדרישות של ה-FPGA המתקדמים ביותר לתוך תהליך הפיתוח של FinFET, ממש כפי שעשתה בפיתוח התהליכים 28HPL ו-20SoC. כדי להשיג תוצאות מיטביות, עתידים להתבצע עוד מיטובים משותפים בכל טכנולוגיית התהליך של TSMC וארכיטקטורת ה-UltraScale של זיילינקס כמו גם בדור הבא של הכלים. UltraScale היא ארכיטקטורת ASIC חדשה שפותחה במטרה לאפשר שינויי סקאלה מטכנולוגיית 20 ננומטר פלנארית, דרך טכנולוגיות FinFET ב-16 ננומטר ומטה, וממונוליטיות עד ICs בתלת ממד.

{loadposition content-related}